

日々進化する半導体デバイスとそのパッケージング技術に対応すべく、絶えず改良検討が求められる封止材料—
日本企業が市場での地位を確保し続けるために、封止材料の基礎から製造、先端応用技術まで総合解説!



～応用技術を押さえて機能化設計・先端デバイス適用の糧に～ 半導体封止材料の配合設計・製造応用技術と 先端パッケージ対応

≪半導体封止材料の設計・製造技術 総合解説 2日間コースセミナー≫



日時	2020年12月3日(木) 10:30～16:30	会場	Live配信セミナー ※会社・自宅にしながら学習可能です※
受講料	49,500円 ⇒テレワーク応援キャンペーン 【Live配信/WEBセミナー受講限定】 1名申込みの場合:受講料 定価:35,200円/S&T会員 33,440円 ※ 同一企業から複数名S&T会員で受講される場合は本割引ではなく、「2名同時申込みで1名分無料」割引を適用させていただきます。		資料付

講師 (有)アイバック 代表取締役 越部 茂 氏

趣 旨 半導体は、「樹脂封止」の採用(1970年代)により急成長を遂げ汎用化した。日本は、樹脂封止用の「封止材料」の分野で市場を制圧し続けている。今回、封止材料の基本技術および応用技術を2日間にわたり徹底解説する。講師は、封止材料およびその関連技術の開拓および改良に40年以上携わっており、講演は半導体パッケージング関係者へ技術伝承する内容となっている。
第2日目の本講では、封止材料の応用技術を分かり易く説明する。充填剤(シリカ)の配合・表面処理技術、触媒活性や各種機能剤の活用まで、具体的な封止材料の配合設計について解説する。さらに、高速化対応PKGや高発熱型パワーデバイス、混載型パッケージ等、先端デバイスにおける封止材料への要求・ニーズについても解説する。また、最近の国際状況、「もの作り」への回帰(ハード見直し)等についても説明する。

プログラム	第1講 封止材料設計・製造の応用技術 ～シリカ・触媒・機能剤配合～	第2講 半導体パッケージ技術の進化への対応
	<ol style="list-style-type: none"> 1. シリカ配合と封止材料特性との関係 2. シリカの表面処理技術 3. シリカの分散技術 4. シリカの課題 5. 触媒の活性制御 6. シラン系処理剤の活用技術(カップリング剤, 表面処理剤) 7. シランカップリング剤処理技術 8. 他の機能剤の活用技術 	<ol style="list-style-type: none"> 9. 半導体パッケージング技術開発の動き 10. IT分野と封止技術 11. 自動車分野と封止技術 <p>□ 質疑応答 □</p>

本セミナーはビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信となります。予め「Zoom」のインストールが可能か、接続可能か等をご確認ください。
セミナー資料は電子ファイルでの配布、郵送のいずれかになります。詳細はホームページをご確認下さい。
本セミナーは、11/26開催『封止材料基礎』セミナーとのセット申し込みがございます。詳細は、弊社ホームページをご覧ください。

■2名同時申込みで1名分無料■
(1名あたり定価半額の24,750円)

※2名様ともS&T会員登録をしていただいた場合に限りです。 ※他の割引は併用できません。
※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。
※3名様以上のお申込みの場合、左記1名あたりの金額で受講できます。
※受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。
※請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。(通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。)

※講師、プログラムの内容が変更になる場合もございます。最新の情報はHPにてご確認ください。※申込用紙が複数枚必要な場合等は、本用紙をコピーしてお使いください。

セミナー申込用紙 B201233 (封止材料応用)

会社名 団体名			
部署			
役職	〒		
ふりがな	住所		
氏名			
TEL	FAX		
E-mail	※申込みに関する連絡に使用するため、可能な限りご記入ください。		

※太枠の中をご記入下さい。 ※□にチェックをご記入ください。
※E-mailアドレスまたはFAX番号を必ずご記入下さい。

今後のご案内	
<input type="checkbox"/> E-mail希望・登録済み <input type="checkbox"/> 郵送希望・登録済み <input type="checkbox"/> 希望しない	S&T会員価格を 適用いたします。 (E-mailアドレス必須)
お支払方法	
<input type="checkbox"/> 銀行振込 (振込予定日 月 日) <input type="checkbox"/> 当日現金払い	
通信欄	
※個人情報の取り扱いについて ご記入いただいた個人情報は、 事務連絡・発送の他、情報案内等に使用いたします。 詳しくはホームページをご覧ください。 ●キャンセル規定 開催日から逆算(営業日:土日・祝祭日等を除く)いたしまして、 ・開催7日前以前のキャンセル: キャンセル料はいただきません。 ・開催3～6日前でのキャンセル: 受講料の70% ・開催当日～2日前でのキャンセル・欠席: 受講料の100% ※ご注意※ 参加者が最少催行人数に達しない場合など、 事情により中止になる場合がございます。	

●受講料について
「2名同時申込みで1名分無料」については上記の注意事項をお読みください。
●お申込みについて
申込用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXでお申込みください。
また、当社ホームページからでもお申込みいただけます。
お申込みを確認次第、請求書・受講券・会場案内図をお送りします。
●お支払いについて
受講料は、銀行振込(原則として開催日まで)、
もしくは当日現金にてお支払いください。
銀行振込の場合、原則として領収書の発行はいたしません。
振込手数料はお客様がご負担ください。

サイエンス & テクノロジー
研究・技術・事業開発のためのセミナー/書籍
サイエンス&テクノロジー株式会社
TEL 03-5733-4188 FAX 03-5733-4187
〒105-0013
東京都港区浜松町1-2-12 浜松町F-1ビル7F
http://www.science-t.com